

LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI10_2+6b+2_1,00_17.5

10 - Lagen

Kerne: 0,15 mm Cu 17.5/17.5 μm



WE-Artikel Nr.:

2 + 6B + 2

KUNDE:

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG	
KUNDE	WE					[μm]	[μm]	
1	TOP/VS		Folie	12 μm	1) 1 x 1080	12 60		
2	VSK2		Folie	12 μm	1 x 1080	30 60		
3	VSK1		Folie	12 μm	1 x 1080	35 66		
4	2		0,150 mm	17.5 μm		16 150		
5	3		17.5 μm	2 x 1080	16 134			
6	4		0,150 mm	17.5 μm	16 150			
7	5		17.5 μm	1 x 1080	66			
8	RSK1		12 μm	1 x 1080	35 60			
9	RSK2		Folie	12 μm	1 x 1080	30 60		
10	BOT/RS		Folie	12 μm	1) 1 x 1080	12		
		1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 μm						
Gesamtdicke Material:						1024		

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	1,00	+/-	0,08	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,08	+/-	0,11	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,14	+/-	0,13	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision
28.03.2006	S. Keller	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00

Seite: |20+